

다전공 이수 체계 안내



2026년 06월 22일

교무처 학사팀

◎ 다전공 이수제도

1. 복수전공(제2전공) 이수(졸업 시 2개 이상의 학위를 취득하는 제도)

- 1) 복수전공을 이수하고자 하는 학생은 신청기간 이내에 포털시스템에서 신청(본인의 교육과정 적용연도에 맞는 학과로 신청) 후 저장
- 2) 복수전공 신청 제한 학과 : 유아교육과, 보건계열(간호학과, 물리치료학과, 임상병리학과, 식품영양학과), 동물보건복지학과 건축학과, 예체능계열 학과, 미래융합스쿨(구. 미래융합대학) 학과, 국제학부, 자유전공학부
- 3) 제1전공 교과목과 복수전공 교과목은 15학점 이내에서 중복 인정 가능

▣ 복수 전공 이수 체계

1) 일반학과 및 전공

- 2023학번까지

소속 계열	단일전공 이수 시	복수전공 이수 시	
		1전공	2전공
인문 · 사회/자연과학, 공학 계열	59~69	47	32
예체능계열	71	57	32

- 2024학번부터

소속 단과대학	단일전공 이수 시	복수전공 이수 시	
		1전공	2전공
인문 · 사회/자연과학, 공학 계열	59~69	39	33
예체능계열	71	51	33

*예체능계열 학과 : 디자인스쿨, 애니메이션학과, 사회체육학과, 골프산업학과, 문화영상학부, 공연예술학부

2) 광역학부

- 동일 학부 내 다중 트랙 이수 시 (전체 학번 공통)

전공이수학점		전공이수기준		
		공통트랙	심화트랙1	심화트랙2
일반	59	24	23	23
예술계열	71	20	35	35

※동일 학부 내에서는 복수전공이 아니며 다중 트랙임

□ 타 학부 및 타 전공 복수 전공 이수 시

■ 1전공과 2전공 모두 광역학부일 경우

학번	구분	학부학위 취득 시 이수학점	트랙 학위 취득 시 이수 학점	
			공통트랙	심화트랙
~2023학번	1전공	47학점	1전공 학부학위 취득 시 이수학점 - 심화트랙 이수 학점	심화트랙 이수 학점
	2전공	32학점	12학점	20학점
2024학번~	1전공	39학점	10학점	29학점
	2전공	33학점	9~12학점	21~24학점

■ 1전공이 광역학부이고 2전공이 일반 학과/전공일 경우

학번	구분	학부학위 취득 시 이수학점	트랙 학위 취득 시 이수 학점	
			공통트랙	심화트랙
~2023학번	1전공	47학점	1전공 학부학위 취득 시 이수학점 - 심화트랙 이수 학점	심화트랙 이수 학점
	2전공	32학점		
2024학번~	1전공	39학점	10학점	29학점
	2전공	33학점		

■ 1전공이 학과/전공이고 2전공이 일반 광역학부일 경우

학번	구분	학부학위 취득 시 이수학점	트랙 학위 취득 시 이수 학점	
			공통트랙	심화트랙
~2023학번	1전공	47학점		
	2전공	32	12학점	20학점
2024학번~	1전공	39학점		
	2전공	33	9~12학점	21~24학점

2. 부전공 이수(학위증에 '부전공'으로 표기)

- 1) 부전공 이수학점은 해당 학과의 전공과목으로 21학점 이상 취득
- 2) 부전공 신청 제한 학과 : 미래융합스쿨(구, 미래융합대학) 학과(단, 미래융합대학 소속학과 학생은 스쿨 내 부전공 신청 가능), 국제학부, 자유전공학부
- 3) 제1전공 교과목과 부전공 교과목은 9학점 이내에서 중복 인정 가능

□ 일반학과 다전공 신청 가능 여부

단과대학	학부(과)	신청 가능 여부	
		복수전공	부전공
AI공과대학	전기공학과	○	○
	시스템제어공학과	○	○
	안전공학과	○	○
	소방방재학과	○	○
	화학공학과	○	○
	건축토목공학부	○	○
	건축학과(5년제)	×	○

단과대학	학부(과)	신청 가능 여부	
		복수전공	부전공
	환경공학과	○	○
	기계공학과	○	○
	미래자동차공학과	○	○
	전자재료공학과	○	○
	정보통신공학부	○	○
	빅데이터시학부	○	○
	컴퓨터공학부	○	○
	게임소프트웨어학과	○	○
	전자공학과	○	○
	반도체공학과	○	○
	지능로봇학과	○	○
바이오헬스대학	식품공학과	○	○
	제약공학과	○	○
	화장품과학과	×	×
	생명공학과	○	○
	식품영양학과	×	○
	동물보건복지학과	×	○
	간호학과	×	○
	물리치료학과	×	○
	임상병리학과	×	○
아트앤컬처대학	기독교학과	○	○
	사회체육학과	×	○
	골프산업학과		○
	디자인스쿨		○
	실내디자인학과		○
	디지털프로덕트디자인학과		○
	시각디자인학과		○
	산업디자인학과		○
	애니메이션학과		○
	문화영상학부		○
	공연예술학부(실용음악, 연극)		○
글로벌융합대학	한국언어문화학과	○	○
	영어영문학과	○	○
	중국학과	○	○
	법경찰행정학과	○	○
	산업심리학과	○	○
	사회복지학부	○	○
	청소년문화 · 상담학과	○	○
	유아교육과	×	○
	미디어커뮤니케이션학과	○	○
	항공서비스학과	○	○
	글로벌통상학과	○	○

단과대학	학부(과)	신청 가능 여부	
		복수전공	부전공
	경영학부	○	○
	디지털금융경영학과	○	○
	국제학부	×	×
글로벌융합대학 (미래융합스쿨)	산업안전공학과	△	△
	사회복지상담학과	△	△
	스마트경영학과	△	△
	기계반도체공학과	△	△
교양대학	자유전공학부	×	×
-	국제산학융합학부	×	×

3. 연계전공 이수 체계

전 공	개 설 교 과 목		이 수 기 준		
	개설학부(과)	교 과 목 명	복수전공	부전공	마이크로디그리
반도체후 공정	전자융합 공학부	기초프로그래밍, 응용프로그래밍, 광전자공학, 반도체디스플레이재료, 자동제어, 반도체공정실습1,2, 반도체공학, 자동제어응용, 반도체소자시뮬레이션및응용, VLSI설계, 인공지능과데이터분석1,2, 장비설계, 영상처리공학1, 반도체PKG기술1, 반도체제조장비, 플라스마진공이론및실습, 전력반도체공정, 확률통계와반도체품질관리, 반도체PKG기술2, 실무특강1,2, 현장실습/인턴쉽(4주), 현장실습/인턴쉽(8주), 디지털논리회로, PKG소재기술	-	부전공	-
	전자재료 공학과	전자재료물성, 나노재료및소자, 박막제조공정			
	화학공학과	CAD기초및실습, 머신러닝과매트랩기초및실습, 기초반도체공정및설계,			
친환경 모빌리티	기계자동차 공학부	프로그래밍 언어, 지능형자동차 기초실험 1,2, 자동차공학개론, 미래자동차, CAD, 열역학, 열전달, 유체역학, 응용유체역학, 냉동특론, 동역학, 센서공학, 기계제어, 차량설계 및 실습, 차량제작 및 실습, 기계설계프로젝트1,2, 현장실습, 모빌리티응용실습, 마이크로열유체, 유공압시스템, 공기조화냉동, 전기전자개론, 진공및유체기계, 기계요소설계, 열역학실험, 스마트자동차전기실습2, 미래자동차구조실습2	-	최소 21학점 이상 수강 및 현장실습 참여	-
	자동채CT 공학과	미래자동차CT, 센서및계측공학, 자동차전기기기1,2, 자동차기초회로실험1,2			
	전기공학과	회로이론1,2			
반도체패 키지공정	반도체공학과	반도체PKG기초, PKG공정기술 산학프로젝트1, 패키지실무세미나1, 산학프로젝트2, 반도체공정실습1, 반도체공정실습2, 반도체제조혁신1, PKG설비기술, 반도체테스팅, PKG소재기술, 반도체제조혁신	복수전공	-	-
	로봇공학과	PLC프로그래밍, 전자회로, 임베디드프로그래밍, 지능제어시스템, 지능형IoT, 로봇공학, 응용기계설계, 패턴인식			

전 공	개 설 교 과 목		이 수 기 준		
	개설학부(과)	교 과 목 명	복수전공	부전공	마이크로디그리
	지능로봇학과	전자회로, 로봇비전, 자동제어, 임베디드시스템, 로봇공학, 모터제어, 로봇메커니즘설계, 패턴인식			
	전자공학과	자동제어, 임베디드시스템, PLC제어, 전자회로실무, 센서공학, 인공지능기초, 전자회로1, 전자회로2, 마이크로프로세서, 응용전자실험1, 응용전자실험2, 반도체공학, 반도체소자및공정			
	전자융합공학부	자동제어, 임베디드시스템, PLC제어, 센서공학, 인공지능기초, 전자회로1, 전자회로2, 마이크로프로세서, 반도체공학, 디지털응용실험, 응용전자실험, 반도체공정실습1, 반도체공정실습2, 전자공학1, 반도체PKG기술1			
	기계자동차공학부	센서공학, 메카트로닉스및실습, 기계시스템설계, 기계제어, 메카트로닉스공학, 메커니즘설계, CAE			
	기계공학과	기구학, 센서공학, 기계제어, 메카트로닉스공학, 기계시스템설계			
	미래자동차공학과	CAE, 센서공학, 메커니즘설계, 기계제어, 메카트로닉스및실습			
반도체패키지설계	반도체공학과	반도체PKG기초, PKG공정기술 산학프로젝트1, 패키지실무세미나1, 산학프로젝트2, 반도체공정실습2	복수전공	-	-
	전자공학과	임베디드시스템, 초고주파공학, 신호및시스템, 정보신호처리, 전력반도체설계, 반도체공학, 반도체소자및공정, 센서공학, 디지털반도체설계			
	전자융합공학부	자동제어, 임베디드시스템, 초고주파공학, VLSI설계, 신호및시스템, 정보신호처리, 반도체공학, 센서공학, 디지털반도체설계, 반도체공정실습1, 반도체공정실습2, 전자공학1, 반도체PKG기술1			
	기계자동차공학부	동역학, 열전달, 기계제어, CAD, 응용유체역학, 냉동특론, 마이크로열유체, 공기조화냉동, 3D-CAD, 모빌리티열관리시스템			
	기계공학과	3D-CAD, 마이크로열유체, 동역학, 열전달, 기계제어, 공기조화냉동			
	미래자동차공학과	동역학, 열전달, 기계제어, CAD, 응용유체역학, 모빌리티열관리시스템			
반도체패키지재료	반도체공학과	반도체PKG기초, PKG공정기술, 패키지실무세미나1, 산학프로젝트1, 산학프로젝트2, 반도체공정실습, 반도체재료, PKG소재기술	복수전공	-	-
	전자재료공학과	박막제조공정, 전자재료물성, 전자재료물성실험, 반도체재료, 나노재료및소자, 전자패키지소재, 마이크로접합소재			
	신소재공학과	전자재료공학, 재료표면처리, 반도체재료			
반도체패키지신뢰성	반도체공학과	반도체PKG기초, PKG공정기술 산학프로젝트1, 패키지실무세미나1, 산학프로젝트2, 반도체공정실습2, 반도체제조혁신1, 반도체제조혁신, 통계분석과반도체품질관리	복수전공	-	-
	전자공학과	신호및시스템, 인공지능기초, 인공지능응용, 초고주파공학, 지능형시스템, 정보신호처리, 응용전자실험1, 응용전자실험2, 임베디드시스템			
	전자융합공학부	신호및시스템, 인공지능기초, 인공지능응용, 초고주파공학, 지능형시스템, 정보신호처리, 임베디드시스템, 디지털응용실험, 응용전자실험, 반도체공정실습1, 반도체공정실습2, 전자공학1, 반도체PKG기술1			
	컴퓨터공학과	오픈소스세미나, 데이터마이닝, 컴퓨터비전, 소프트웨어공학, 소프트웨어품질검증, 데이터분석과클라우드플랫폼, 기계학습, 데이터과학및분석, 데이터베이스, 자료구조, 컴퓨터구조, 컴퓨터네트워크, 운영체제및실습,			

전 공	개 설 교 과 목		이 수 기 준		
	개설학부(과)	교 과 목 명	복수전공	부전공	마이크로디그리
		알고리즘			
스마트팩토리	AIT스쿨 (컴퓨터공학과)	리눅스기초및실습, 데이터과학및분석, 오픈소스하드웨어플랫폼, 지능형IoT, Physical AI기초프로젝트, Physical AI심화프로젝트, 패턴인식과영상처리, 산학협력프로젝트			
	미래자동차공학과	자동차공학개론, 유체역학, 고체역학, 열역학, 동역학, 모빌리티메커니즘설계, 모빌리티응용실습, 메카트로닉스및실습	복수전공	부전공	마이크로디그리
	전자융합공학부	마이크로프로세서, 정보신호처리, 통신시스템, 자동제어, 영상처리공학1			
	기계자동차공학부	미래자동차(캡스톤디자인), 센서공학			
스마트모빌리티	컴퓨터공학부	리눅스기초및실습, 데이터과학및분석, 오픈소스하드웨어플랫폼, 지능형IoT, Physical AI기초프로젝트, Physical AI심화프로젝트, 패턴인식과영상처리, 산학협력프로젝트	복수전공	부전공	마이크로디그리
	미래자동차공학과	자동차공학개론, 유체역학, 고체역학, 열역학, 동역학, 모빌리티메커니즘설계, 모빌리티센서공학, 모빌리티응용실습, 메카트로닉스및실습			

* 제1전공 교과목과 복수, 부전공 교과목은 15학점(9학점) 이내에서 중복 인정 가능

5. 융합트랙 이수 체계

융합트랙명칭	이수기준	
	복수전공	부전공
인문빅데이터융합트랙 기술기반문화창업트랙 4차산업혁명융합트랙 비즈니스한국어통번역트랙	최소 32학점 이상 수강 (트랙 전공필수 12학점)	트랙에서 최소 21학점 이상 수강 (트랙 전공필수 9학점)
데이터소프트웨어융합트랙	-	트랙에서 최소 21학점 이상 수강

* 제1전공 교과목과 복수, 부전공 교과목은 15학점(9학점) 이내에서 중복 인정 가능

6. 차세대디스플레이

1) 전공 심화형

다전공	영역별 이수 기준	이수학점	
복수전공	입문/기초소양/트랙공통초급	12+	36
	전공 초급/중급	15+	
	전공 고급	6+	
	WE-MEET	3+	
부전공	입문/기초소양/트랙공통초급	6+	21
	전공 초급/중급	9+	
	전공 고급/WE-MEET	6+	

2) 전공 융합형

다전공	영역별 이수 기준	이수학점	
복수전공	입문/기초소양/트랙공통초급	12+	36
	트랙별 전공 초급/중급/고급	12+	
	WE-MEET	3+	
	융합 선택 교과목 (선택 전공 외)	9+	
부전공	입문/기초소양/트랙공통초급	6+	21
	트랙별 전공 초급/중급/고급/WE-MEET	9+	
	융합 선택 교과목 (선택 전공 외)	6+	

* 차세대디스플레이 혁신융합대학 세부 교과목은 우측 링크 참조



7. 학생설계전공

전공명	개설학부(과)	교과목명	이수기준
			복수전공 (33학점)
디지털 마케팅	중국학과	중국지역경제론, 현대중국의국제관계, 중국투자자와마케팅의이해	전공별 33학점 이상 이수 *1전공 이수 교과목 중 6학점 까지 중복인정
	산업심리학과	소비자심리학, 광고심리학	
	미디어커뮤니케이션학과	영상커뮤니케이션개발론, SNS마케팅, 미디어콘텐츠스토리텔링 한류와글로벌콘텐츠, 광고커뮤니케이션	
	경영학부	마케팅(벤처), 해외비즈니스기초, 서비스마케팅, 소비자행동론, 광고관리	
디자인 마케팅	산업심리학과	심리학입문, 소비자심리학	
	미디어커뮤니케이션학과	SNS마케팅, MD와편성, 광고커뮤니케이션	
	경영학부	마케팅(벤처), 광고관리, 마케팅조사론	
	디지털기술경영학과	경영학원론, 디지털비즈니스시장조사론	
	시각디자인학과	creative design, 현대디자인론, 브랜드디자인1, 브랜드패키지디자인1, 브랜드포트폴리오, C.패키지프로젝트	
예술심리 치료학	산업심리학과	상담이론과실제, 성격심리학, 임상심리학, 심리검사, 이상심리, 집단상담(캡스톤디자인)	
	사회복지학부	정신건강사회복지론, 사회복지실천론, 가족상담및치료	
	청소년문화 · 상담학과	발달심리, 학습부진아학업상담	
	융합학부	감정치료이론과실습, 놀이를통한자기이해	
	혁신융합학부	공연영상미디어와치유	
스마트팜 응용공학	빅데이터시학부	머신러닝2, 스마트품질경영	
	화학공학과	화학공장설계, 공정제어, 유기화학1, 유기화학2	
	컴퓨터공학부	파이썬프로그래밍, 지능정보입문설계, 논리회로와스마트센서설계, 데이터베이스, 지능형IoTWSW	
	융합학부	인공지능스마트팜기초, 스마트팜모빌리티기초, 스마트팜캡스톤디자인	